

# 非硅型导热薄材 XK-FN30

## 简介:

XK-FN 非硅型导热薄材，主要应用于硅氧烷敏感应用,在车灯,镜头,雷射装置,通讯器材,航天设备等有显著差异,没有硅氧烷挥发影响光学性质与电学性质可能, XK-FN 系列为高分子材料混掺陶瓷填料,以玻璃纤维布为基材,可以确保尺寸安定性,施工容易

## 特质:

- 1.采用 Polyester 树脂为基底
- 2.无硅氧烷挥发

## 应用:

LED 车灯  
光学精密设备



	unit	XK-FN30	Method
Reinforcement Carrier		Fiberglass	visual
Color		Blue	
Thickness	mm	0.25	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm <sup>3</sup>	3	ASTM D792
Hardness	Shore A	75	ASTM D2240
Thermal impedance	°Cin <sup>2</sup> /W	0.28	ASTM D5470
Thermal Conductivity	W/mK	3	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 <sup>13</sup>	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV/mm	>3.5	ASTM D149
Dielectric Constant	1	6.5	ASTM D150
Application temperature	°C	-30~125	
Tensile strength	psi	>1000	ASTM D149
Elongation	%	30	ASTM D149
Siloxane Volatiles D4~D20	%	<0.01	GC-FID
Flammability	UL94	V-0	UL94